

双组份导热灌封胶

GF400是一款低粘度高效导热有机硅双组份灌封胶，分为A、B组分，按照1:1混合，混合均匀后能自排泡和常温固化，固化后具有防尘、防水防震、阻燃、密封、粘接、导热功能和优异的填缝效果，可用于发热电子元件的导热封装。



特性和优点

- 操作时间可调
- 高电气绝缘
- 流动性、浸润性好
- 可实现自动化作业

典型应用

- OBC, DC-DC, 连接器, 传感器, 放大器等
- LED, 电源, 功率转换器, 变压器, 高压电阻器

***操作时间:** 混合后，在操作时间内使用完毕

典型属性		
属性	典型值	测试方法
颜色(A/B)	黄色/白色	目视
黏度(mPa·s)	part A: 12500±2500	ASTM D2196 DV2T粘度计 @7号转子, 转速100rpm
	part B: 11500±2500	
操作时间(h) @25°C	>2	A/B按1:1混合后黏度值上升到初始黏度两倍的时间
固化时间(h) @25°C	<24	A/B按1:1混合后
固化后		
密度(g/cc)	3.15±0.1	ASTM D792
硬度(Shore A)	15~30	ASTM D2240
拉伸强度(MPa)	≥0.2	ASTM D412
断裂伸长率(%)	≥30	ASTM D412
耐温范围(°C)	-40~150	/
防火性能	V-0	UL 94
保质期(月)	6	温度<40°C密封储存、避免暴晒
电性能		
击穿电压(kV/mm)	≥8.0	ASTM D149
介电常数	6 (典型值)	ASTM D150 @1MHz
体积电阻率(Ω·cm)	≥10 ¹²	ASTM D257
导热性能		
导热系数(W/(m·K))	>3.6	ISO 22007-2